

# 大分LSI Cluster活動介紹

## 研究開發

### 測試、評估技術領域

- 測試器燒機研究WG(工作小組)**  
確立開發LSI測試裝置時所需的穩定的高信賴性接觸技術的研究開發
- 有關燒機裝置的燃燒室性能的研究WG**  
小型且與生產量相對應的多樣少量型燒機裝置開發
- 測試器研究WG**  
透過與計測器相組合,實現低價的高速信號測試
- ALPG研究WG**  
小型低價的高速圖形產生器回路的研究開發
- 高速混合信號簡易測試器開發WG**  
小型低價的高速混合信號簡易測試器的開發



有關燒機裝置的燃燒室性能研究  
(小型燃燒室)



測試器的研究



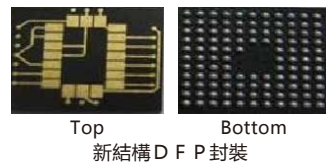
IC插座連接部的清洗

### 裝置部品清洗技術領域

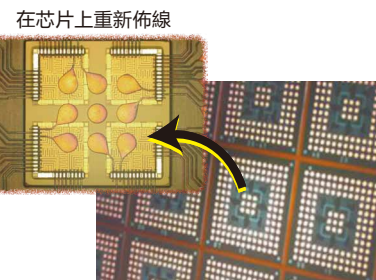
- 利用CO<sub>2</sub>清洗機的燒機板清洗系統的開發WG**  
確立利用CO<sub>2</sub>清洗機的燒機板清洗技術

### 貼裝技術領域 (新封裝技術)

- Fan-Out型WLP用面板比例尺實現低成本重新佈線的技术開發WG**  
利用面板比例尺對Fan-Out佈線·底板(PAD)連接總括工藝的適用,實現封裝用低成本重新佈線工藝的開發
- 用於手機的新結構DFP封裝開發WG**  
為實現薄型化、低成本的新結構DFP封裝的開發



Top Bottom  
新結構DFP封裝

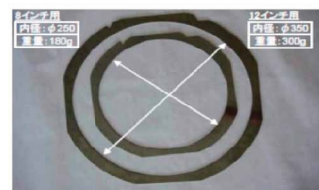


在芯片上重新佈線

板的外觀(個片化之前)

### 裝置部品技術分野

- 12英寸輕量貼片環的開發WG**  
重量減輕60%的12英寸貼片環的開發
- 塑膠貼片環開發WG**  
輕量、強韌、價廉的8英寸用高剛型塑膠貼片環的開發



貼片環



交換器裝置

### 裝置化技術領域

- 交換器開發WG**  
針對Final Test用插座的探針,實現自動且高速進行交換之裝置的開發

## 人才培育

### 舉辦半導體基礎講座

針對新進公司的職員、事務部門、間接部門的人員、舉辦半導體技術講座。



電源設備研討會(共3次)

### 舉辦技術人員進修會

針對半導體相關技術人員、舉辦電源設備、MEMS、醫學等向今後有望發展的技术領域挑戰為目的、進行系統性技術進修會。



2012.6.28-29台灣、  
中國商務能力提高進修會

### 舉辦面向海外開展的提高能力進修會

為擴大與台灣、韓國等東亞地區的貿易、舉辦商務能力提高進修會。

## 販路開拓、訊息提供

### 需求(needs)與策略(seeds)的調查、展示會等商務媒合的支援

- 透過需求(needs)與策略(seeds)的調查進行商務媒合**  
參訪縣內外的大型半導體相關企業調查需求和策略、與半導體機構的會員迅速進行商務媒合、以擴大貿易規模。
- 參加展示會**  
參加號稱世界之最大的半導體裝置材料國際展示會之日本半導體展示會、強力宣傳大分縣內企業、同時介紹研究開發的成果。



2012.12.5-7 日本半導體展示會

### 與台灣、韓國進行商務交流

透過與台灣電子設備協會締結了相互交流的備忘錄、促進雙方商務交流的同時、持續推進與韓國蔚倉(Ochang)半導體機構和韓國產業團地工團(KICOX)之間的商務交流。



2012.5.11  
與韓國企業進行商機洽談會(大分)



2012.12.3  
洽談成立的簽字儀式

## 會員交流

### 舉辦企業代表研討會

面向國內外的企業代表的交流會。



2012.9.14 企業代表研討會

### 舉辦交流會

- 舉辦技術人員交流會**  
以會員企業的技術人員為對象進行交流會。
- 其他交流活動**  
與其他地區的機構或海外進行交流以構築交流網。